

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二二年中期業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二二年七月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生及張仰學先生；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

ASMPT 公布二零二二年中期業績

* * *

二零二二年上半年毛利率表現強勁 銷售收入按年增長 10.1% 至 13.4 億美元

儘管身處不明朗的宏觀經濟環境，
依然憑著半導體強勁的長期需求，
全力推進

集團業績概覽

集團財務概要：二零二二年第二季度

- * 銷售收入為港幣 52.0 億元(6.64 億美元)，按年+0.5%，按季則-1.2%
- * 新增訂單總額為港幣 46.5 億元(5.93 億美元)，按年-36.5%，按季亦-34.0%
- * 強勁的毛利率為 41.7%，按年+110 點子，按季亦+104 點子
- * 經營利潤率為 18.8%，按年+85 點子，按季則-22 點子
- * 盈利為港幣 9.05 億元，按年+23.5%，按季亦+9.0%

集團財務概要：二零二二年上半年

- * 銷售收入為港幣 104.7 億元(13.4 億美元)，按年+10.1%，按半年則-15.8%
- * 新增訂單總額為港幣 116.9 億元(15.0 億美元)，按年-22.8%，按半年則+6.6%
- * 強勁的毛利率為 41.2%，按年+104 點子，按半年亦+21 點子
- * 經營利潤率為 18.9%，按年+212 點子，按半年則-148 點子
- * 盈利為港幣 17.3 億元，按年+37.6%，按半年則-9.4%
- * 每股中期基本盈利為港幣 4.21 元，按年+38.0%，按半年則-9.9%
- * 中期股息每股港幣 1.30 元，按年持平
- * 最高為港幣 4.20 億元的股份回購計劃
- * 於二零二二年六月三十日，未完成訂單總額為港幣 111.8 億元(14.2 億美元)

二零二二年第三季度銷售收入預測

- * 將介乎 5.6 億美元至 6.3 億美元之間

詳盡業績公布及投資者簡報可見於

<https://www.asmpacific.com/zh-tw/financial-results>

(二零二二年七月二十一日，香港訊) — ASMPT Limited (「ASMPT」/「集團」/「本公司」) (股份代號: 0522) 公布集團截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績。作為全球領先的設備製造商，集團專為半導體及電子產品生產提供硬件和軟件解決方案，其技術使各類的客戶能夠為數碼世界創造廣泛的半導體和電子解決方案。

二零二二年上半年集團亮點

強勁的毛利率和按年銷售收入增長為今年多變的上半年畫上了句號，其特點是在持續不確定的宏觀經濟環境下，對半導體需求仍出現長期強勁、持續的情況。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「儘管供應鏈持續緊張、物流受到限制、通脹壓力、地緣政治衝突和中國對 2019 冠狀病毒病疫情的防控措施影響我們及市場上的其他同業，但集團仍取得強勁的業績表現。我們的策略性措施推行進展順利，使我們繼續在主要領域擴展技術和市場領導地位，深入開拓新市場，並更有效率營運。值得提及的是，集團的毛利率已連續五個季度保持在 40% 以上。」

二零二二年上半年集團業務亮點

汽車電動化強勁趨勢持續推動 ASMPT 獨特的汽車解決方案增長。汽車是集團增長最快的應用領域，佔集團總銷售收入約 20%，約為 2.70 億美元。隨著集團吸納大量新客戶，其汽車工具已準備就緒，以爭取更大的汽車潛在市場份額。

集團獨特且突出的**先進封裝**（「AP」）工具系列正幫助將 ASMPT 打造成整體互連方案的供應商，實現銷售收入約 2.35 億美元，佔集團總銷售收入約 18%。在長期技術趨勢所帶動的客戶持續資本支出承諾的支持下，此增長使集團能夠擴大其在 AP 潛在市場的份額。

集團將**熱壓焊接**（「TCB」）和**混合式焊接**（「HB」）解決方案相結合，並處於獨特地位，隨著主要客戶的先進節點晶圓廠產能¹在未來幾年將加速投產，集團將能夠從中大幅受惠。

¹ 10 納米及以下

- 受先進節點封裝需求所驅動，其先進的晶片與晶圓 TCB 平台正幫助集團鞏固其整體 TCB 市場的領導地位，確保其長期的結構性增長。
- 此增長與 HB 服務的領域重疊，HB 仍處於從逐步過渡至小批量生產的階段。集團繼續專注其資源和投資以提供 HB 工具予客戶認證，並預計其將從二零二三年起對集團的業績將作出重要的貢獻。
- 總體而言，集團有信心其 TCB 和 HB 解決方案組合的潛在市場的增長率將顯著超過半導體封裝及裝嵌設備(「PAE」)市場，而該市場預期於二零二一年至二零二六年的年均複合增長率將為 5.2%。

面板級電化學沉積(面版級 ECD)工具在二零二二年上半年受不斷擴大的客戶群所支持，尤其是高性能計算所推動，訂單增長強勁，在 5G 技術的持續增長(隨著其矽密度和技術要求之提高)和消費者可穿戴裝置的強勁市場需求的支持下，系統封裝(「SiP」)配置工具的勢頭亦持續到二零二二年上半年。

二零二二年上半年集團財務亮點

集團在汽車和工業市場的表現奠定了 13.4 億美元的強勁銷售收入表現(按年增長 10.1%，按半年下跌 15.8%)。集團新增訂單總額為 15.0 億美元(按半年增長 6.6%，按年下跌 22.8%)，使上半年的未完成訂單總額高達 14.2 億美元，訂單對付運比率為 1.12。按半年銷售收入及按年新增訂單總額下降很大程度上是受高基數所影響。

集團毛利率為 41.2%(按年增長 104 點子)，是由於兩個分部均錄得強勁毛利率，主要是來自針對性的定價調整和持續策略性措施所帶來的利潤增加效應所致。然而，由於全球供應鏈緊張，使材料和物流成本上升，抵銷了部份增長。二零二二年上半年的經營利潤率為 18.9%，與往年上半年相比，仍處於較高水平。

盈利(包括 AAMI 的業績持份)為港幣 17.3 億元(按年增長 37.6%)。嚴謹的資本管理使集團於二零二二年上半年末錄得穩健的現金及銀行存款港幣 47.6 億元(二零二一年上半年末為港幣 41.0 億元)。於二零二二年上半年末，現金及銀行存款淨額增至港幣 17.1 億元(二零二一年上半年末為港幣 10.2 億元)。

二零二二年第二季度集團摘要

銷售收入為 6.64 億美元，按年增長 0.5%，按季則下跌 1.2%，略低於上一季度公布第二季度銷售收入預測的 6.7 億美元下限，主要是由於供應鏈緊張及物流限制，加上宏觀經濟的不確定因素導致消費者信心疲弱。集團的新增訂單總額為 5.93 億美元，按季下跌 34.0%，按年下跌 36.5%，兩者下降主要是由於高基數所致。

集團的毛利率為 41.7%（按年增長 110 點子，按季增長 104 點子），主要由於集團 SMT 分部的毛利率表現相對較強。經營利潤率為 18.8%，按年增長 85 點子，按季則下跌 22 點子，而盈利（包括 AAMI 的業績持份）達港幣 9.05 億元，按年增長 23.5%，按季增長 9.0%。

中期股息及股份回購計劃

集團維持以持續派息回報股東的良好往績，董事會宣佈派發中期股息每股港幣 1.30 元（二零二一年上半年：中期股息每股港幣 1.30 元），按年持平。自一九八九年上市以來，集團一直堅持每年派發股息。

此外，董事會已批准股份回購計劃（「股份回購計劃」），根據股份回購計劃，本公司將以最高達港幣 4.20 億元用作回購本公司在市場上買賣的股份。【有關股份回購計劃的進一步詳情將載於本公司的另一份自願性公告。】董事會相信股份回購計劃反映董事會及管理團隊對集團長期策略及增長前景充滿信心，並認為股份回購計劃符合集團及其股東整體利益。實施股份回購計劃將提高集團的每股盈利並提高股東整體回報。

展望未來

正如全球半導體行業的眾多企業，集團繼續應對多變和充滿挑戰的經營環境。在短期內，集團專注於完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及 2019 冠狀病毒病疫情引起的不確定性仍然是制約因素。因此，集團預計二零二二年第三季度的銷售收入將介乎 5.6 億美元至 6.3 億美元之間。

作為半導體市場的領導企業，集團期望將受惠於這樂觀的行業增長預測，例如 TechInsights 預測半導體 PAE 市場將從 65 億美元（二零二一年）增長至 84 億美元（二零二六年），複合年增長率為 5.2%。

黃先生指出：「雖然近期的不確定性影響短期前景，但行業的長期前景依然強勁。簡單而言，由於半導體仍然是我們日益數碼化世界的根基，全球矽消耗將會急劇加速，我們預計作為半導體價值鏈主要推動因素的半導體資本設備，將經歷長期的結構性增長。」

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT (香港聯交所股份代號:0522)是領先全球之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT (表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT 是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 <https://www.asmpacific.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢:

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話: +65 6450 1445
電郵: eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT:

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣 / 張鋤婷
電話: 2864 4812 / 2864 4862 / 2864 4870
傳真: 2527 1196
電郵: mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk / jill.cheung@sprg.com.hk